

HB솔루션 회사 소개서

디스플레이/반도체 공정 High-Tech Solution 기업



글로벌 선도 기술력

초박막
두께 분석

도포

Lamination

Coating

Printing

고분자
물성 분석

다양한 사업 포트폴리오

디스플레이
전공정

디스플레이
후공정

반도체

이차전지

태양전지

신소재

글로벌 Top-tier 고객사

SAMSUNG

SAMSUNG DISPLAY

LG Display

BOE

TIANMA

CSOT

AUO

SK 하이닉스

회사 연혁

Display 전· 후공정 및 반도체 장비 Total Solution 제공



2001년
LET 설립
(Display 후공정
모듈 장비)

2018년
HB 그룹 편입

KOSDAQ
2020년
코스닥 상장

HB SOLUTION

2021. 7. 1
HB 솔루션 합병



1996년
케이맥 설립
(Display 전공정
반도체 장비)

KOSDAQ
2011년
코스닥 상장

2015년
HB 그룹 편입

합병회사 LET
피합병회사 케이맥

합병 후 사명 변경
HB 솔루션

2001년 설립된 디스플레이/반도체 장비 전문 기업

일반 현황

회사명	에이치비솔루션 주식회사
대표이사	이재원
설립일	2001년 9월 6일 (2021년 엘이티, 케이맥 합병)
자본금	348억 원(2023년 12월 말 기준)
주요사업	디스플레이 및 반도체 장비 제조
사업장	본사: 충청남도 아산시 연암울금로 77-26 지점: 대전광역시 유성구 테크로 8로 33 해외법인: 베트남, 중국, 대만
임직원수	230명(2024년 3월 말 기준)
Website	http://www.hb-solution.co.kr

CEO



대표이사 이재원

- 2021.07 ~ 현재 HB솔루션 대표이사
- 2015.09 ~ 2021.07 前 케이맥 대표이사
- 2011.04 ~ 2024.03 HB테크놀로지 사장
- 2004.04 ~ 2006.01 前 보이스웨어 대표이사



디스플레이 검사/도포 및 반도체, 이차전지 장비 사업 영위

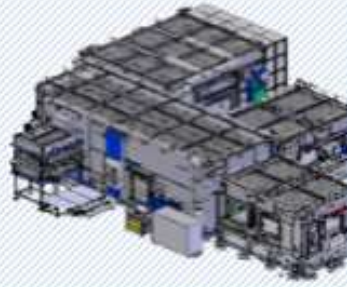
<p>디스플레이 전공정</p> <p>주력 장비</p>  <p>원장검사기 (원장 예이징 및 검사기)</p> <p>챔버 3종 검사장비 (회절 특성 측정 후에 측정 검사 등)</p>	<p>디스플레이 후공정</p> <p>주력 장비</p>  <p>ELB (빛샘 방지 도포)</p> <p>BPL (Bending 배선부 레진도포 및 검사)</p> <p>CRD (IC와 FPCB 접착부 레진 도포)</p>	<p>반도체</p> <ul style="list-style-type: none"> 반도체 300 mm 웨이퍼공정에서 비파괴적으로 조성 및 두께를 평가 TOF-MEIS 세계 최초 상용화 및 시장 진입  <p>Stand-alone Type TOF-MEIS</p>	<p>잉크젯</p>  <p>Inkjet Coating</p>
<p>기타</p> <p>ST6000/8000</p> <p>STER</p> <p>ICM</p> <p>STCM</p> <p>SRCD</p> <p>WLSI</p> <p>SPD</p>	<p>기타</p> <p>FoD</p> <p>UTG 자동착용기</p> <p>Potting</p> <p>복합기</p> <p>배면도포기</p> <p>Side sealing</p>	 <p>300mm WF 분석용 TOF-MEIS</p>	<p>이차전지</p>  <p>검사기, 도포기 등</p>

주요장비_디스플레이 전공정

챔버 3종 검사장비

글로벌 시장 점유율 1위

- OLED 점등 후 화질, 특성, 색이상 검사
- Mask 틀어짐 PPA 검사
- OLED 유기물 초박막 두께 계측



원장검사기

고객사와 공동 개발, 첫 수주 완료

- Cell 점등 후 화질, 특성, 색이상 검사
- Glass 원장상태에서 Cell 검사 가능
- In-Line 설비



ST6000/ST8000(반사도 측정기)

글로벌 시장 점유율 1위

- 공정모니터링용 광학식 두께 측정
- 빠른 측정 속도
- Sub micron spot size 구현
- 글로벌 특허 보유



STER(타원편광분석기)

글로벌 시장 점유율 80%
(삼성디스플레이 100%, LG디스플레이 90%)

- Ellispometer 박막 두께 측정
- 최대 10종막의 두께 분리 계측 기술
- 최소 60 x 30 μ m spot size, In-Line 설비화

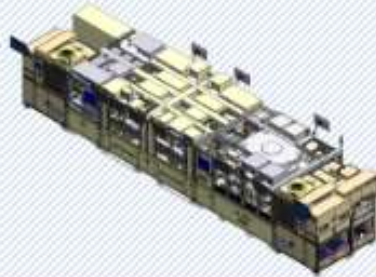


주요 장비_디스플레이 후공정

ELB

글로벌 시장 점유율 1위(휴대폰용)
중소형 디스플레이 확대 중(IT)

- 카메라홀, 디스플레이 노치 등 빛샘 방지 도포 및 검사 수행



CRD

삼성디스플레이 점유율 1위

- IC와 FPCB 접착부에 레진 도포 및 검사 수행
- Phone 및 Auto motive에 적용



FoD(Fingerprint on Display)

국내 최초 국산화 및 양산 개발
Foldable & Rollable 확대 예상

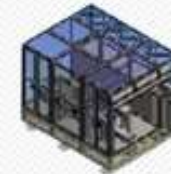
- Flexible OLED Display에 지문 센서 부착 및 검사 수행



TV용 후공정 장비



복합기



배면 도포기



Side Sealing

주요 장비_반도체 장비

반도체 분석기기 Nano-MEIS
(R&D Lab. 用)



반도체
연구용
&
불량 분석

적용공정

특징

진행상황

반도체 물질 등 소재박막 성분을 분석하는 표면 분석 장비

- 반도체 시료 초박막 계면, 정성, 정량 분석장비
- 원자층 수준의 2Å 두께 분해능 가능
- 비파괴적 측정 방식, 수소 등 정량 분석 가능
- 분석 자동화 시스템 구현

* 2013년 신기술(NET : New Excellent Technology) 인증 획득

SK Hynix 분석실 공급 및
한국기초과학지원연구원
(KBSI)수주

반도체산업 맞춤형 TOF-MEIS
(In-Line 向)



반도체
박막공정
(샘플링 모니터링)

적용공정

특징

진행상황

300mm 웨이퍼 공정에서 조성/두께를 정량적 분석

- 12" Wafer 기반 박막 공정 모니터링 적용 가능
- Wafer Test Pattern 분석 용 25 μ m 이온빔 구현
- MEIS Spectra Library 이용 실시간 결과도출
- OHT FOUP 시스템 대응 및 현장 맞춤형 장비

국내 글로벌 반도체 기업과
JDP 진행중
(시료 Test 진행 등)

"Global No.1 Equipment Solution Company"



"Global No.1 Hi-Tech Solution"



교육체계

구분		성장단계 조력	전문성 강화			조직 이해			기타	법정필수
회사주도	임원	CEO 참여 코칭, 전략, 변화				CEO 참여 리더 워크숍		CEO 주관	리더 인사이드	'직장 내' 성희롱 예방 산업안전보건 개인정보보호 '직장 내' 장애인인식개선 퇴직 연금 '직장 내' 괴롭힘 예방
	팀장	CEO 강평 조직/성과관리						CEO 강평	사보 발행	
	G3	리더준비 교육 (비직책자) CEO 강평	산업의 이해	1인1技 전문가	기술 세미나				Insight 특강 비정기	
	G2	전문인재 교육 승진자 교육	Biz	Tech	People	팀 빌딩	CA 워크숍	경영 설명회	사내강사 육성	
	G1	미래인재 교육	X Tech	X Job	X Tech				추천교육 큐레이션	
	입사자	CEO Tea Talk 365 Journey	비정기						생활고민 해소	
개인주도		✓ 성장단계, 직무필요 등에 따라 본인이 선택 수강 <div style="float: right; margin-top: 10px;"> 사외 온라인 </div>								



G2/G3 승진자 교육
 "MBTI에 기반한 업무방식"
 "디스플레이 공정 교육 "



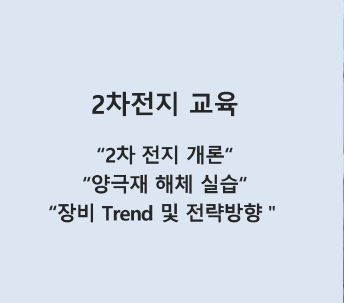
HB 열린인재 교육
 "반도체/AI산업의 미래"
 "업무 프로세스 분석과
 데이터 마이닝 "



Chat GPT 교육
 "Chat GPT를 활용한 업무 자동화"
 "보고서 제작 프로젝트 "



G2/G3 승진자 교육
 "석식간담회 "



2차전지 교육
 "2차 전지 개론"
 "양극재 해체 실습"
 "장비 Trend 및 전략방향 "



리더십 워크샵
 "Team of Power 활동"
 "사업계획 토의"
 "코칭 리더십 "



Feedback

(승진자교육)

강의 만족 4.41/5점, 강사 만족 4.34/5점

- 승진자들이 함께 소통하는 시간이 마련되어 좋았음
- 디스플레이 공정을 학습하여 업무 이해도를 높일수 있어서 좋았음

(열린인재교육)강의 만족 4.45/5점, 강사 만족 4.65/5점

- 동종업계 현황 및 전망을 확인하고 새로운 패러다임을 마주함
- "Innovation"이 아닌 "현장 Improvement"로 전략을 바꾸는 계기가 되었음

(2차전지교육) 강의 만족 4.32/5점, 강사 만족 4.45/5점

- 2차전지 산업 진입 가능성과 어려움에 대한 분석이 좋았음
- 배터리 노칭공정의 가능성, 레이저 노칭기술의 한계극복에 대한 고민을 할 수 있었음.

(ChatGPT교육) 강의 만족 4.82/5점, 강사 만족 4.89/5점

- 평소 알고있던 방식이 아닌 다양한 방법으로 문제를 해결할수 있어서 좋았다.
- Chat GPT외에도 다양한 업무Tool을 배울 수 있었다.

(리더십교육) 강의 만족 4.33/5점, 강사 만족 4.55/5점

- 구성원들간 소통, 친목도모를 할 기회가 생겨 좋았고, 팀장 스스로 리더의 역할을 고민해볼 기회가 되었다.

조직문화



[HB 가족한마당]



[변화관리자 워크샵]



[커피차 Event]



[스크린 골프 대회]



[동호회 활동]



[연말 사진전]

복리후생

1. 인센티브(성과급) 제도 운영
2. 야근/휴일 근무 수당 지급
3. 건강지원(정기 건강 검진_연1회(50만원 상당)) / 매월 건강상담)
4. 기숙사 무료 제공 (원거리 거주자) / 통근버스 운영(회사 <-> 기숙사)
5. 명절 귀향여비(설/추석) 및 선물 지급(귀향비 20만원 / 공산품 6만원 상당)
6. 조식/중식/석식 무료 제공_사내식당
7. 어버이날/결혼기념일 선물 지급(꽃바구니)
8. 온라인교육 포털 운영, 교육비 지원_인당 50만원
9. 법인 리조트 제공(한화 리조트, 금호 리조트)
10. 장기근속자 포상 (5년 근속 : 금 5돈, 10년 : 금 7돈, 20년 : 금 10돈, 30년 : 금 15돈)
11. 상조물품 지원
12. 외근 교통비, 업무상 외근 식대, 워크숍 지원
13. 다양한 동호회 활동 지원 (축구, 게임, 등산 등)
14. 해외출장비 지원
15. 회식비 지원
16. 자녀입학 축하금 지원(초등 20만 / 중등 30만 / 고등 50만 / 대학 100만)
17. 임직원 복지몰 운영(인당 30만 포인트 內 자유롭게 사용)

